

# 半导体

证券研究报告

2021年09月05日

## IC设计企业基本面有望超预期，价值投资机会浮现

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

### 本周行情概览：

本周申万半导体行业指数下跌 8.86%，同期创业板指数下跌 4.76%，上证综指上涨 1.69%，深证综指下跌 1.78%，中小板指下跌 2.52%，万得全 A 上涨 0.11%。半导体行业指数显著跑输主要指数。半导体细分板块中，半导体材料板块本周下跌 4.8%，分立器件板块本周下跌 5.4%，半导体设备板块本周下跌 11.1%，半导体制造板块本周下跌 5.7%，IC 设计板块本周下跌 7.6%，封测板块本周下跌 0.2%，其他板块本周上涨 2.1%。

### 半导体 IC 设计企业处于历史估值低位，受到景气度担忧的情绪影响

受全球半导体产品需求旺盛影响，中国集成电路产业继续保持增长态势。根据 wind 数据显示，中国大陆地区 34 家主要半导体 IC 设计企业 1H21 整体营收达到 521 亿元，同比增长 48%；整体净利润达到 93 亿元，同比增长达到 101%。目前，中国大陆半导体 IC 设计企业 PE 为 79 倍，而近一年 PE 最低值为 77 倍，估值相对处于低谷。第三季度通常为手机需求旺季，伴随新能源汽车与 IoT 产品出货量提升，国内 IC 设计企业产品出货量有望持续上涨，推动业绩提升。

### 台积电芯片代工价格上调，IC 设计企业有望同步传导，基本面或持续向上

全球下游终端产品需求旺盛。2021 年 1~7 月，新能源汽车产量达到 150.4 万辆，同比增长 2 倍。同时，全球 IoT 连接设备预计将从 2019 年的 100 亿台增长至 2025 年的 309 亿台，年复合增长率达到 21%。受益于下游强烈需求影响，台积电晶圆出货量持续提升。2020 年起晶圆出货量增幅均保持 14% 以上。2Q21，台积电付运晶圆达到 345 万片（等效 12 吋晶圆），同比增长 15.5%，环比增长 2.68%，再创近一年付运晶圆新高。

受益下游强烈需求，2021 年以来各大晶圆代工厂不断调涨报价，联电、力积电等代工厂已先后调涨报价，且价格呈现逐季调涨趋势。日前，台积电内部决议上调晶圆代工报价，其中 7nm 至更先进制程价格将调涨 10%，16nm 以上的成熟制程将调涨 10~20%。台积电代工芯片报价上涨将造成半导体产品成本提升，半导体 IC 设计厂商或将部分成本转嫁给下游客户。台积电此次涨价属于正常现象，意味着市场将延续供需紧张态势。

### 建议关注：

- 1) **半导体设计**：晶晨股份/中颖电子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易创新/富瀚微/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/芯朋微/斯达半导/新洁能/澜起科技/紫光国微/上海复旦
- 2) **IDM**：闻泰科技/三安光电；
- 3) **晶圆代工**：中芯国际/华虹半导体；
- 4) **半导体设备材料**：北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微；

**风险提示**：疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期

### 作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070005  
panjian@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号：S1110521050001  
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

联系人

chengruiying@tfzq.com

### 行业走势图



资料来源：贝格数据

### 相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:高景气下扩产行情持续，多家公司 H1 业绩亮眼》 2021-08-29
- 2 《半导体-行业研究周报:本土 FPGA 板块有望迎来戴维斯双击》 2021-08-24
- 3 《半导体-行业研究周报:存储技术持续升级迭代，不改长期向上趋势》 2021-08-15

## 内容目录

1. 天风半导体每周谈：IC 设计基本面持续向好，台积电涨价或将带动 IC 价格提升.....	3
1.1. IC 设计企业基本面持续向好，低估值价值投资机会显现 .....	3
1.2. 台积电上调晶圆代工报价，预示明年芯片紧缺延续 .....	5
2. 本周半导体行情回顾.....	6
3. 本周重点公司公告 .....	7
4. 本周半导体重点新闻.....	11
4.1. IC 设计.....	11
4.2. 设备/材料.....	12
4.3. 代工/封测.....	13
4.4. EDA/IP/其他.....	14
5. 周观点： .....	15
6. 风险提示： .....	15

## 1. 天风半导体每周谈：IC 设计基本面持续向好，台积电涨价或将带动 IC 价格提升

### 1.1. IC 设计企业基本面持续向好，低估值价值投资机会显现

IC 设计企业上半年整体营收与净利润增长迅速。受全球半导体产品需求旺盛影响，中国集成电路产业继续保持增长态势。根据 wind 数据显示，中国大陆地区 30 家主要半导体 IC 设计企业 1H21 平均营收达到 19.01 亿元，同比增长 53%，其中大部分公司营收同比增速超过 70%。同时，该 30 家 IC 设计企业平均净利润达到 3.50 亿元，同比增长达到 105%，其中大部分公司净利润同比增长超过 110%。

表 1：部分本土半导体 IC 企业情况汇总（截至 2021 年 8 月 31 日）

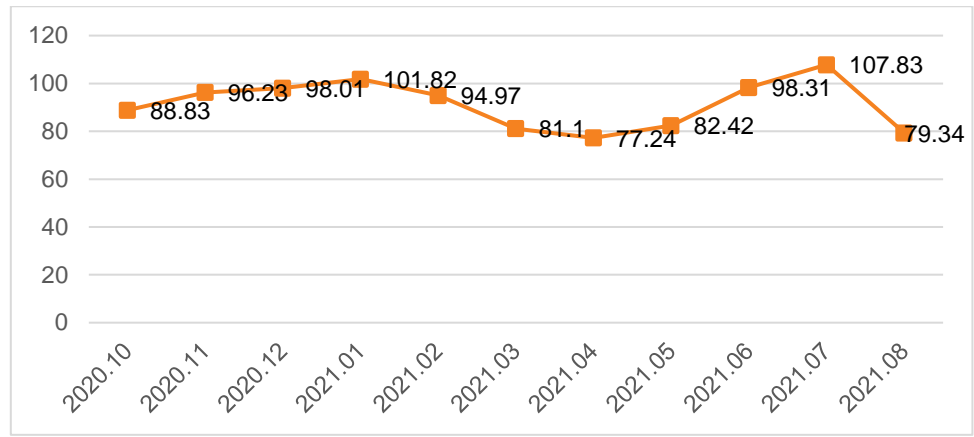
公司	1H21 财务情况 (亿元)				市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)		PE	
	营收	YoY	净利润	YoY		21E	22E	21E	22E
韦尔股份	124.48	54.77%	22.44	126.60%	2103	45.65	59.87	46	35
紫光国微	22.92	56.54%	8.76	117.84%	1357	16.15	23.17	84	59
卓胜微	23.59	136.48%	10.14	187.37%	1264	21.86	29.96	58	42
兆易创新	36.41	119.62%	7.86	116.32%	1021	16.81	22.31	61	46
格科微	36.86	50.99%	6.44	92.14%	841	14.94	21.43	56	39
圣邦股份	9.15	96.66%	2.61	149.16%	752	4.71	6.20	160	121
澜起科技	7.24	-33.51%	3.08	-48.82%	717	10.72	15.10	67	47
北京君正	23.36	558.46%	3.55	2994.80%	668	7.39	9.94	90	67
瑞芯微	13.78	104.50%	2.65	184.70%	578	6.03	8.73	96	66
汇顶科技	29.10	-4.78%	4.21	-29.60%	477	11.82	16.26	40	29
思瑞浦	4.85	60.56%	1.55	26.78%	464	3.42	5.07	136	92
晶晨股份	20.02	111.81%	2.50	499.16%	429	6.16	9.31	70	46
艾为电子	10.67	109.90%	1.22	149.81%	385	2.51	4.82	153	80
纳思达	99.07	0.19%	4.26	18.66%	379	9.25	12.47	43	32
恒玄科技	7.33	117.08%	1.89	286.87%	344	4.67	7.05	74	49
复旦微电	11.29	56.05%	1.94	221.16%	310	4.06	5.75	95	67
晶丰明源	10.66	177.19%	3.36	3456.99%	262	7.64	9.31	34	28
富瀚微	7.18	154.37%	1.39	215.67%	254	3.54	5.20	72	49
国科微	9.52	393.08%	-0.10	49.35%	245	2.25	3.53	109	69
富满电子	8.51	239.31%	3.16	1190.55%	242	9.14	12.46	26	19
全志科技	10.48	75.07%	2.42	181.44%	234	5.08	6.95	46	34
上海贝岭	10.19	87.19%	3.92	337.22%	232	6.93	7.50	33	31
中颖电子	6.86	50.78%	1.53	62.62%	210	3.36	4.66	62	45
乐鑫科技	6.31	115.07%	1.02	192.23%	170	2.50	3.62	68	47
国民技术	2.81	66.12%	0.43	233.18%	165	--	--	--	--
芯朋微	3.26	109.07%	0.70	119.93%	164	1.49	2.21	110	74
博通集成	5.21	58.43%	0.33	-34.12%	115	1.57	2.54	73	45
力芯微	3.70	64.78%	0.62	105.68%	104	1.30	1.86	80	56
聚辰股份	2.64	21.24%	0.66	41.23%	54	1.36	1.63	40	33

资料来源：wind，天风证券研究所

(PE 取 wind 一致估值)

估值水平处于相对低谷，看好 IC 设计企业投资机会。中国大陆半导体 IC 设计企业的估值相对处于低谷，目前市场 PE 为 79 倍，而近一年 PE 最低值为 77 倍。1Q21，IC 设计企业整体估值较低的主要原因在于市场担忧 1) 缺芯影响全球手机需求复苏，以及 2) 国内手机需求疲软。然而，Q3 通常为手机需求旺季，伴随新能源汽车与 IoT 产品出货量提升，国内 IC 设计企业产品出货量有望持续上涨，推动业绩提升。

图 1：半导体 IC 设计板块企业整体 PE-TTM 走势



资料来源: wind, 天风证券研究所

三四季度迎来行业旺季, IC 设计企业环比有望持续向好。半导体 IC 设计企业 Q2 整体营收相较 Q1 有所提升。根据 wind 数据显示, 中国大陆地区 30 家主要半导体 IC 设计企业 2Q21 平均单季度营收达到 10.15 亿元, 环比增长 14.69%, 其中大部分公司 2Q21 单季度营收环比增速超过 20%。同时, 该 30 家 IC 设计企业平均 2Q21 单季度净利润达到 2.12 亿元, 环比增长达到 53.67%, 其中大部分公司净利润环比增长超过 60%。三四季度向来是半导体行业旺季, 随着三四季度的到来, IC 设计企业环比业绩有望持续向好。

表 2: 部分本土半导体 IC 企业财务情况

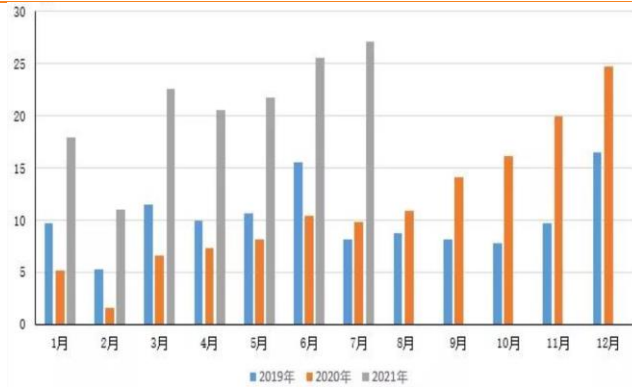
公司	单季度营收 (亿元)			单季度归母净利润 (亿元)		
	2Q21	1Q21	QoQ	2Q21	1Q21	QoQ
韦尔股份	62.36	62.12	0.39%	12.03	10.41	15.55%
紫光国微	13.40	9.52	40.70%	5.52	3.24	70.47%
卓胜微	11.76	11.83	-0.57%	5.22	4.92	6.04%
兆易创新	20.37	16.04	26.99%	4.84	3.01	60.77%
格科微	17.49	19.38	-9.76%	3.52	2.92	20.38%
圣邦股份	5.22	3.94	32.37%	1.85	0.75	145.20%
澜起科技	4.25	3.00	41.87%	1.74	1.34	29.53%
北京君正	12.68	10.68	18.73%	2.35	1.20	94.88%
瑞芯微	8.13	5.65	43.97%	1.53	1.12	37.19%
汇顶科技	14.91	14.19	5.07%	2.64	1.57	68.55%
思瑞浦	3.18	1.67	90.03%	1.24	0.31	296.98%
晶晨股份	10.73	9.29	15.44%	1.60	0.89	79.16%
艾为电子	5.71	4.96	15.23%	0.89	0.33	168.45%
纳思达	50.50	48.57	3.98%	2.11	2.15	-2.22%
恒玄科技	4.43	2.91	52.34%	1.09	0.80	37.16%
复旦微电	6.27	5.02	24.83%	1.08	0.86	24.96%
晶丰明源	6.58	4.08	61.47%	2.67	0.69	285.30%
富瀚微	5.06	2.12	138.75%	1.04	0.35	199.97%
国科微	5.40	4.12	31.26%	-0.11	0.01	-1066.95%
富满电子	5.85	2.66	119.82%	2.55	0.62	313.85%
全志科技	5.47	5.01	9.02%	1.56	0.86	80.74%
上海贝岭	5.90	4.29	37.51%	2.53	1.39	81.85%
中颖电子	3.80	3.06	23.90%	0.85	0.68	26.10%
乐鑫科技	3.60	2.71	33.12%	0.68	0.34	98.59%
国民技术	1.84	0.97	88.64%	0.59	-0.16	465.34%
芯朋微	1.84	1.43	28.81%	0.41	0.30	37.75%
博通集成	2.85	2.36	20.53%	0.23	0.10	124.85%
力芯微	2.03	1.66	22.39%	0.38	0.24	55.54%
聚辰股份	1.31	1.33	-1.49%	0.49	0.17	198.52%

资料来源: wind, 天风证券研究所

## 1.2. 台积电上调晶圆代工报价，预示明年芯片紧缺延续

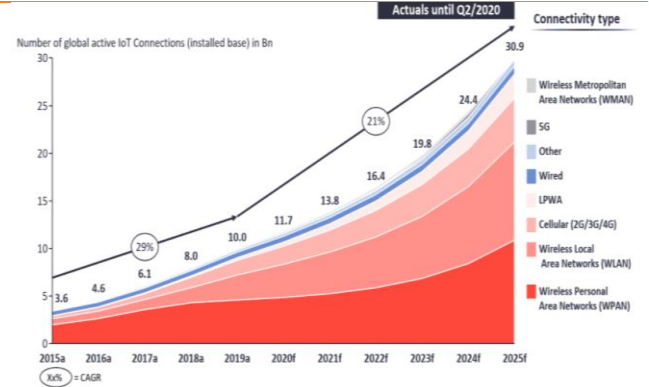
看好下游新的应用需求，新能源汽车与 AIoT 进入快速成长期。全球下游终端产品，例如汽车、AIoT 等产品出货量持续提升，带动晶圆出货量提升。根据中国汽车工业协会统计分析，2021 年 7 月新能源汽车产量达到 28.4 万辆，环比增长 14.3%，同比增长 1.7 倍。2021 年 1~7 月，新能源汽车产量达到 150.4 万辆，同比增长 2 倍。同时，全球 IoT 连接设备出货量将受益于 5G 和智能家居的普及而持续增长。预计 2019~2025，全球 IoT 连接设备将从 100 亿台增长至 309 亿台，年复合增长率约 21%。

图 2：新能源汽车月度销量（万辆）



资料来源：中国汽车工业协会，天风证券研究所

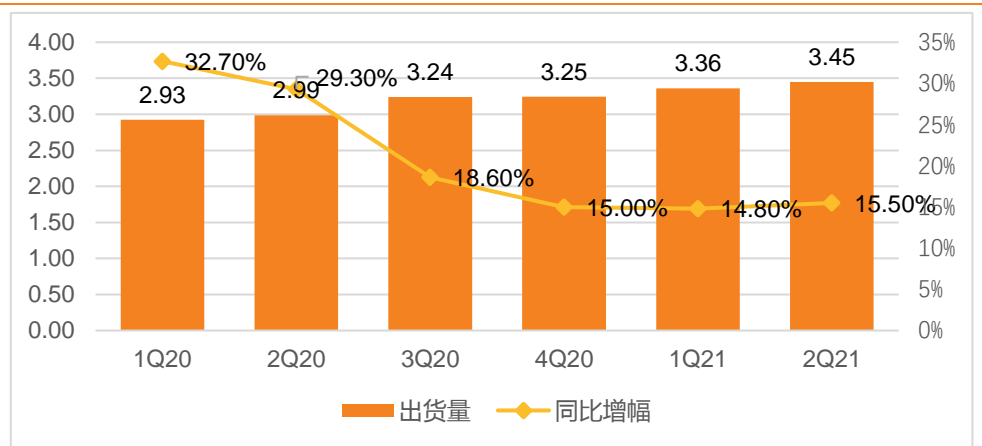
图 3：IoT 连接设备出货量（十亿台）



资料来源：公司公告，公司官网，天风证券研究所

受益下游强烈需求，台积电付运晶圆再创新高。受益于下游强烈需求影响，台积电晶圆出货量持续提升。2020 全年，台积电晶圆出货量稳步增长，同比增幅均保持 15% 以上。1Q21，台积电付运晶圆达到 336 万片（等效 12 吋晶圆），同比增长 14.80%，环比增长 3.38%；2Q21，台积电付运晶圆达到 345 万片（等效 12 吋晶圆），同比增长 15.5%，环比增长 2.68%，再创近一年付运晶圆新高。

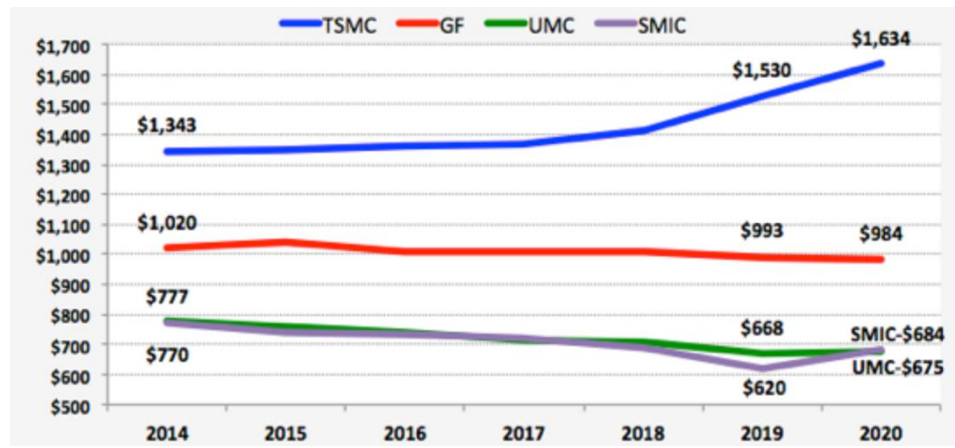
图 4：台积电付运晶圆情况（百万片，等效 12 吋晶圆）



资料来源：公司公告，天风证券研究所

台积电价格上调，或将导致半导体产品涨价。由于下游需求旺盛，2021 年以来各大晶圆代工厂不断调涨报价，联电、力积电等代工厂已先后调涨报价，且价格呈现逐季调涨趋势。日前，台积电内部决议将调涨晶圆代工报价，其中 7nm 至更先进制程将调涨 10% 价格，16nm 以上的成熟制程将调涨 10~20%。台积电代工芯片报价上涨将造成半导体产品成本提升，因此半导体 IC 设计厂商或将部分成本转嫁给下游客户。

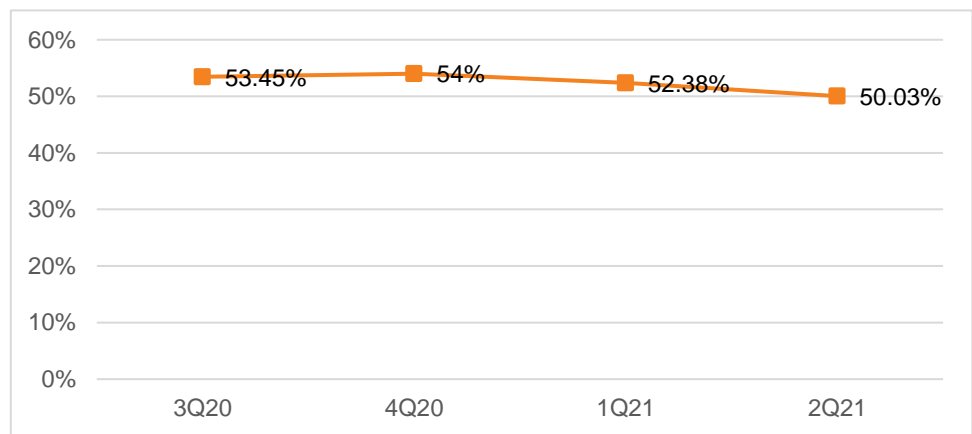
图 5：部分代工厂晶圆单价走势



资料来源：IC Insights，天风证券研究所

台积电涨价属于正常现象，市场将延续供需紧张态势。受上游材料紧缺影响，原材料价格持续上涨。2021 年上半年在其它晶圆厂纷纷采取涨价措施的情况下，台积电选择以取消优惠政策的方式来减少成本压力。然而，全球材料供应依旧紧张，导致台积电 1H21 上半年毛利率持续下滑。为保障权益，台积电决定涨价。所以，此次涨价属于正常现象。同时，此次涨价也意味着产能将延续紧缺态势，市场旺盛需求尚未得到满足。

图 6：台积电毛利率情况



资料来源：wind，天风证券研究所

## 2. 本周半导体行情回顾

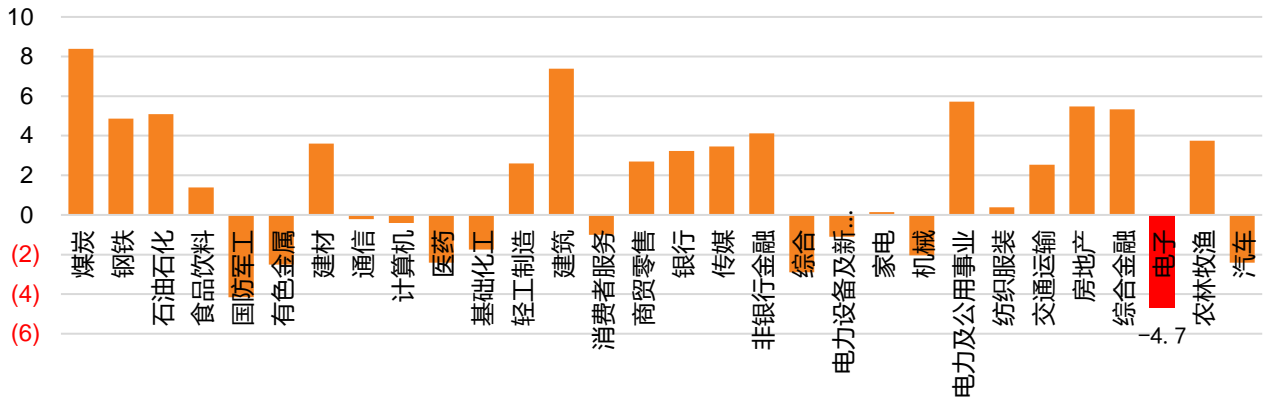
本周半导体行情回调幅度较大。本周申万半导体行业指数下跌 8.86%，同期创业板指数下跌 4.76%，上证综指上涨 1.69%，深证综指下跌 1.78%，中小板指下跌 2.52%，万得全 A 上涨 0.11%。半导体行业指数相较于主要指数显著回调。

表 3：本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	-4.76	-4.10
上证综合指数	1.69	-10.55
深证综合指数	-1.78	-7.08
中小板指数	-2.52	-6.34
万得全 A	0.11	-8.97
半导体 (申万)	-8.86	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

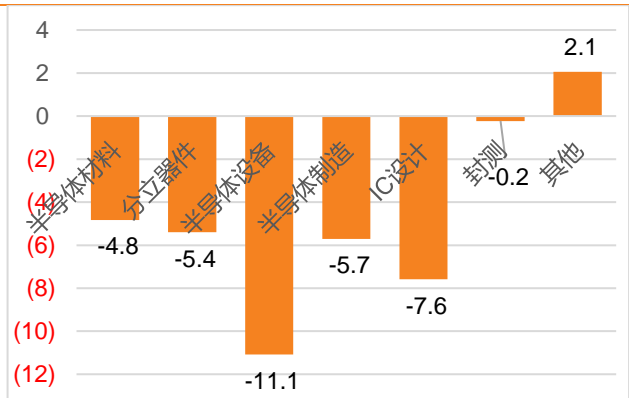
图 7：本周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

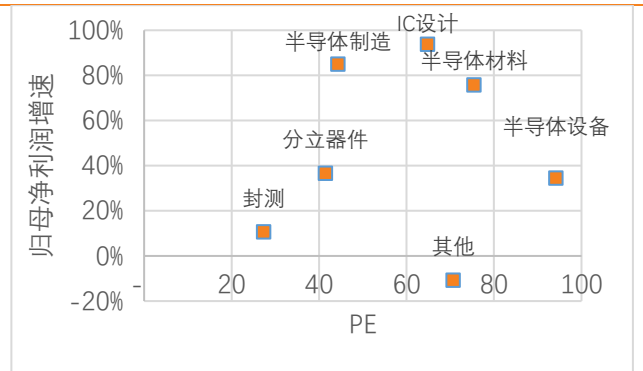
半导体各细分板块整体均有所回调。半导体细分板块中, 半导体材料板块本周下跌 4.8%, 分立器件板块本周下跌 5.4%, 半导体设备板块本周下跌 11.1%, 半导体制造板块本周下跌 5.7%, IC 设计板块本周下跌 7.6%, 封测板块本周下跌 0.2%, 其他板块本周上涨 2.1%。

图 8: 本周子板块涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 9: 半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源: Wind, 天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 宏微科技、国民技术、苏州固得、纳思达、欧比特、思瑞浦、上海贝岭、芯原股份-U、澜起科技、太极实业。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 斯达半导、至纯科技、国科微、长川科技、芯海科技、芯朋微、兆易创新、北方华创、瑞芯微、华峰测控。

表 4: 本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅
宏微科技	21%	斯达半导	-19.1%
国民技术	16%	至纯科技	-18.5%
苏州固得	10%	国科微	-17.9%
纳思达	8%	长川科技	-17.8%
欧比特	6%	芯海科技	-16.6%
思瑞浦	5%	芯朋微	-15.8%
上海贝岭	4%	兆易创新	-15.7%
芯原股份-U	4%	北方华创	-15.6%
澜起科技	2%	瑞芯微	-15.3%
太极实业	13%	华峰测控	-14.1%

资料来源: Wind, 天风证券研究所

### 3. 本周重点公司公告

【圣邦股份 300661.SZ】

公司于 2021 年 8 月 30 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，自 2020 年下半年起至报告期内，半导体集成电路行业持续出现产能紧张、芯片缺货、价格上涨等现象，终端厂商纷纷加大元器件备货力度，公司业务在旺盛的市场需求加持下保持了快速增长。公司除了扩大与现有供应商的合作，也增加了新供应商的投入，以期达到扩充产能，提升产出和缓解交付压力。公司继续加大研发投入，积极进行产品推广，充分发挥公司产品在性能和品质等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持持续稳定的增长。

报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入 91,546.45 万元，同比增长 96.66%；实现净利润 25,720.27 万元，同比增长 148.57%，其中，归属于母公司股东的净利润 26,052.05 万元，同比增长 149.16%。

#### 【通富微电 002156.SZ】

公司于 2021 年 8 月 30 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，报告期内，公司紧紧抓住市场发展机遇，积极发展核心优势产品，推进差异化的市场发展策略。公司继续在高性能计算、5G 通讯产品、存储器和显示驱动等领域，积极布局产业生态链，加强与 AMD、联发科、卓胜微、长鑫存储、长江存储等国内外各细分领域头部客户的深度合作。在 SOC、MCU、电源管理、功率器件、天线通讯产品等高速增长领域，继续发挥公司现有优势，扩大与国内外重点战略客户的深度合作。同时，在国产 FCBGA 产品方面，市场拓展成绩显著，收入、利润同比翻番。2021 年上半年，公司实现营业收入 70.89 亿元，同比增长 51.82%，净利润 4.12 亿元，同比增长 219.13%。营收、利润双双创出历史新高。

#### 【立昂微 605358.SH】

公司于 2021 年 8 月 30 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，2020 年三季度以来，受到“疫情经济”、半导体国产替代加快以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加等多种因素的影响，国内半导体行业进入了快速发展期，公司所处行业细分领域市场景气度不断提升。公司主营的半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片产品的市场需求旺盛，2021 年公司对半导体硅片、半导体功率器件芯片实施了涨价。公司前几年布局了硅片新产线的建设并实施了功率器件产线的产能技改提升，公司储备的产能较为充足地满足了不断趋热的市场需求，另外通过工艺技术创新、管理提升和精益化生产，在技术改进、产品结构优化、良率提升和成本费用控制等方面成果显著，有效的提升了产能与品质。基于以上因素的影响，报告期内公司实现营业收入 10.28 亿元，较上年同期增长 58.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，较上年同期增长 174.21%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，较上年同期增长 234.00%；实现基本每股收益 0.52 元，较上年同期增长 147.62%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 元，较上年同期增长 206.67%；加权平均净资产收益率 10.72%，较上年同期增加 5.8 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.43%，较上年同期增加 5.88 个百分点。

#### 【斯达半导 603290.SH】

公司于 2021 年 8 月 30 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，2021 年上半年，公司实现营业收入 7.19 亿元，较 2020 年上半年同期增长 72.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.54 亿元，较 2020 年上半年同期增长 90.88%，扣除非经常性损益的净利润 1.42 亿元，较 2020 年上半年同期增长 105.13%。同时，公司主营业务收入在各细分行业均实现稳步增长：（1）公司工业控制和电源行业的营业收入为 5.01 亿元，较上年同期增长 52.06%；（2）公司新能源行业营业收入为 1.84 亿元，较上年同期增长 162.92%；（3）公司变频白色家电及其他行业的营业收入为 0.34 亿元，较上年同期增长 106.09%。



### 【北方华创 002371.SZ】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，报告期内，国内新冠肺炎疫情防控常态化，我国经济持续稳定恢复，公司主营业务下游市场需求保持增长态势，公司电子工艺装备和电子元器件业务迎来良好发展机遇。在积极落实疫情防控要求前提下，通过加强市场开拓，提升生产效率和服务能力，有效保障了客户订单的交付周期，使公司经营业绩实现持续增长。报告期内，公司实现营业收入 36.08 亿元，同比增长 65.75%，归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，同比增长 68.60%，截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 218.25 亿元，同比增长 24.59%，归属于上市公司股东的净资产 71.12 亿元，同比增长 4.89%。

2021 年上半年，公司电子工艺装备和电子元器件业务发展态势良好。半导体装备业务方面，芯片市场整体需求旺盛，集成电路逻辑器件、先进存储、先进封装等产线新建及扩建需求上升；在“碳达峰、碳中和”目标指引下，光伏行业投资增长；5G 应用、汽车电子等需求拉动了第三代半导体产线投资快速增长，叠加新型显示等泛半导体产线投资需求，为公司半导体装备业务提供了成长空间。公司刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机、ALD 等设备新产品市场导入节奏加快，产品工艺覆盖率及客户渗透率进一步提高，在集成电路领域主流生产线实现批量销售，第三代半导体、新型显示、光伏设备产品线进一步拓宽，出货量实现较快增长。公司真空热处理设备在市场拓展方面取得良好进展。电子元器件方面，受益于下游市场的需求放大，公司电子元器件业务同比实现较快增长。

### 【北京君正 300223.SZ】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，报告期内，公司各产品线市场需求旺盛，总体营业收入呈快速增长趋势，带动了净利润的持续增长。公司实现营业收入 23.36 亿元，同比增长 588.46%，实现净利润 3.56 亿元，同比增长 2994.80%。其中，公司因收购产生的存货、固定资产和无形资产等资产评估增值，其折旧与摊销等对公司报告期损益的影响金额合计为 0.37 亿元；在北京矽成层面，其因收购 ISSI 形成的无形资产和固定资产增值摊销在报告期内对其利润的影响金额为 0.30 亿元。上述资产增值摊销与公司经营情况关联关系较小，对公司现金流亦不造成影响。

### 【长川科技 300604.SZ】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，报告期内，受到疫情及中美关系的影响，公司及时调整研发及销售策略，实现营业收入及净利润的双增长，其中营业收入 6.73 亿元，同比增长 111.53%；归属于上市公司股东的净利润 0.90 亿元，同比增长 239.44%。同时，公司继续加大研发投入力度，2021 年上半年研发经费投入达 1.43 亿元，占营业收入比例的 21.17%。1H21，公司已授权专利数量 381 项专利权（其中发明专利 273 项，实用新型 107 项，外观设计 1 项），52 项软件著作权。

### 【富满电子 300671.SZ】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《关于控股股东减持计划期满的公告》。公告显示，公司于 2021 年 8 月 31 日收到集晶香港出具的《减持计划实施情况确认函》，2021 年 8 月 26 日，集晶香港通过集中竞价和大宗交易的方式减持股份 232,000 股，占公司股份 0.11%。2021 年 8 月 31 日，集晶香港减持计划期满，集晶香港通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份 4,813,780 股，占公司股份 2.53%。

### 【华微电子 600360.SH】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，报告期内，受中美贸易摩擦与新一轮产业技术革命等因素影响，半导体芯片国产化进程快速推进。公司紧紧抓住国产化替代契机，以产业政策为指导，充分发挥自身产品、技术优势，持续推进产品结构、客户结构、市场结构“三项结构调整”发展战略。同时，加大产品研发投入，加大产品市场推广力度，实现了公司产品在中高端市场的规模化应用。公司充分发挥功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测试为一体的 IDM 企业技术研发优势，积极布局宽禁带半导体，加速产品转型，努力开发应用于汽车电子、电力碳中和、储能逆变等领域的产品，向战略性新兴领域快速拓展，为公司可持续发展、提升盈利能力以及主营业务增长奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 9.92 亿元，同比增长 23.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.27 亿元，同比上升 43.59%。

#### 【博通集成 603068.SH】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，经历 2019 年交通部推广 ETC 安装带来的 ETC 市场爆发式增长后，2020 年由于 ETC 市场需求放缓，给相关产品的销售和业绩带来一定压力，2020 年公司经营业绩有所下滑，但公司持续加强 Wi-Fi、蓝牙音频等新产品的研发并拓展市场客户，相关努力成果在 2021 年上半年逐步得以体现。公司 2021 年度上半年实现营业收入 5.21 亿元，与去年同期相比增加 58.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元，与去年同期相比减少 34.12%。

#### 【韦尔股份 603501.SH】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《控股股东减持股份计划公告》。公告显示，公司控股股东虞仁荣先生（持有公司股份 273,435,000 股，占公司目前总股本的 31.48%）因个人资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 900,000 股，通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 7,000,000 股，共计减持不超过 7,900,000 股，占公司目前总股本的 0.91%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

#### 【泰晶科技 603738.SH】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司 2021 年 1~6 月实现营收 5.63 亿元，同比增长 131.37%；归母净利润达到 0.96 亿元，同比增长 1725.80%。

受益于 5G、物联网、车联网等技术创新及产业应用的需求激增和国产替代进口步伐加速，电子元器件行业景气度持续走强，公司订单量充足。公司依托半导体光刻工艺技术优势，加大优势产品的产能扩充，新增募投项目顺利实施推进，MEMS 微纳米光刻车间完成二期工程建设，SMD 小型号扩大了产线布局，2021 年上半年，随着新增产能逐步释放，系列产品的总产能进一步提高，公司实现主营产品总产量 16.49 亿只，主营业务收入 5.04 亿元，二季度主营业务收入 2.92 亿元，环比一季度增长 37.72%。

#### 【兆易创新 603986.SH】

公司于 2021 年 8 月 31 日公告《股东减持股份计划公告》。公告显示，朱一明先生和香港赢富得有限公司拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持股份，减持期间为：集中竞价方式自本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，大宗交易方式自本公告披露日起 5 个交易日后的 6 个月内。朱一明先生拟减持公司股份不超过 1,328 万股，不超过公司总股本约 2%；香港赢富得有限公司拟减持公司股份不超过 806 万股，不超过公司总股本约 1.21%。若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。

朱一明先生持有公司股票 56,412,613 股，约占公司总股本（664,315,107 股）的 8.49%；香港赢富得有限公司持有公司股票 32,289,040 股，约占公司总股本的 4.86%。

#### 【雅克科技 002409.SZ】

公司于 2021 年 9 月 2 日公告《关于持股 5%以上股东拟减持部分公司股份的预披露公告》。公告显示，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）持有公司股份 26,532,876 股，占公司总股本的 5.73%，计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 4,628,535 股（占目前公司总股本的比例约 1%）。

#### 【士兰微 600460.SH】

公司于 2021 年 9 月 3 日公告《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》。公告显示，本次交易向大基金发行新增股份 82,350,000 股，中登公司已于 2021 年 9 月 1 日出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

## 4. 本周半导体重点新闻

### 4.1. IC 设计

**英国监管单位、欧盟决定针对英伟达收购 Arm 案进行双重调查。**英伟达 2020 年 9 月宣布以 400 亿美元收购 Arm，但过程一波三折。综合外媒报道，英国竞争与市场管理局（CMA）决定第二阶段审查英伟达并购 Arm 案，而第一阶段调查于今年 4 月开始，由英国文化大臣 Oliver Dowden “以国家安全为由”发表公共利益干预通知。据悉，CMA 第二阶段调查时间最长达 24 周，并可延长最多 8 周。若一切顺利，CMA 将在明年 2 月下旬公布决议，调查时间延长的话，会到明年 4 月公布。与此同时，欧盟预计 9 月初开始对并购案展开正式调查，调查很可能在英伟达正式通知委员会收购 Arm 计划后开始。（半导体行业观察）

**景略半导体与韦尔股份签署战略合作，携手发力车载视频传输芯片。**8 月 30 日，据景略半导体官微消息，景略半导体与韦尔股份达成战略合作，旨在车载视觉技术领域展开合作，携手为下一代智能汽车提供端到端高速图像数据的传输、处理和网络通信解决方案。双方将成立一家全新的半导体芯片合资公司，专注车载视频传输芯片的研发和市场开拓。（半导体行业观察）

**联发科：天玑 810 首获 realme 采用，将率先于印度上市。**手机芯片大厂联发科 8 月 30 日与 realme 共同宣布，新款 5G 芯片天玑 810 系列将搭载在 realme 新款手机，成为首款采用该芯片的手机，预计本季就会在印度上市，可望挹注本季营收。（半导体行业观察）

**瑞萨电子完成对 Dialog 的收购，聚焦物联网、工业及汽车领域。**瑞萨于 8 月 31 日宣布，已完成对英商 Dialog Semiconductor 的收购，总股权价值约 48 亿欧元。瑞萨总裁兼首席执行官 Shibata 表示，合并后的公司将致力于利用一系列不断增长的机遇，包括物联网、工业和汽车领域。同时，瑞萨预计，合并后的公司将带来约 2 亿美元的收入增长，运营效率可节约 1.25 亿美元的成本费用。（半导体行业观察）

**英特尔携手台积电推出 Xe-HPG 架构 GPU。**处理器龙头英特尔公布全新独立显卡架构 Xe-HPG。新架构首批 GPU 将采用台积电 N6 制程，并于 2022 年第一季上市。这也是英特尔 1998 年发表 i740 以来，20 多年后再次踏入独立 GPU 市场。市场人士表示，ASIC 和 FPGA 都在 GPU 竞争时，英特尔选择发展 GPU，说明 GPU 可能还是通用 AI 的最好选择。同时，英特尔还在发展 oneAPI 计划，成为英伟达 CUDA 的强大竞争对手。就英伟达、AMD、英特尔布局来看，尽管独立 GPU 不能完全取代 CPU，但也将成为数据中心非常关键的一环。（半导体行业观察）

**vivo：vivo 自研芯片 V1 公布，将由 vivo X70 系列首发搭载。**9 月 1 日，vivo 正式公布自研芯片 V1，该颗芯片将由 vivo X70 系列首发搭载。据悉，vivo V1 是一颗影像芯片。此前在媒体沟通会上，vivo 执行副总裁胡柏山介绍，vivo V1 不仅是一颗特殊规格的集成电路芯片，也是 vivo 多年来芯片策略的一次具体落地，能够同时服务用户在拍照和录像等应用下的需求。（半导体行业观察）

## 4.2. 设备/材料

**科翰龙：自主研发晶圆打码机 WM-SC800R 通过验收。**8 月 31 日，据北京亦庄消息，今日，北京经开区企业科翰龙装备技术股份有限公司自主研发的晶圆打码机 WM-SC800R 通过验收。该台打码机是国内首台通过 FAB 厂验收的具有自主知识产权的晶圆 ID 打码设备，实现了国产晶圆 ID 打码设备“从零到一”的突破，在自主可控道路上迈出了关键的一步。（半导体行业观察）

**住友化学：计划在韩国建厂生产 ArF 光刻胶，预计将于 2024 年投产。**8 月 31 日，日本住友化学在其官网宣布决定扩大其用于先进半导体工艺的光刻胶生产能力。新闻稿指出，住友化学将在大阪工厂（日本大阪河野谷）扩建浸入式 ArF 和 EUV 光刻胶生产线，同时也计划在其全资子公司韩国东宇精细化学株式会社益山厂建立一座新的 ArF 浸没光刻用光刻胶生产工厂。住友化学表示，大阪工厂计划于 2023 财年上半年开始投产，东宇精细化学益山工厂计划于 2024 财年上半年开始投产。预计在大阪工厂的产能扩建和此次新建工厂后，住友化学的 ArF 光刻胶产能将于 2024 年度提升至 2019 年度产能的 2.5 倍。（半导体行业观察）

**晶盛机电：获 60.83 亿元单晶炉订单，向下游 CVD 设备延伸。**8 月 31 日晚，晶盛机电发布公告称，公司于 2021 年 8 月 31 日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额 60.86 亿元（含税）。合同内同规定 2021 年 11 月开始设备交付，具体交付计划以宁夏中环正式通知为准。同时，根据公司官微消息，9 月 1 日，子公司浙江求是半导体设备有限公司开园仪式在临平区举行，标志着晶盛机电从半导体材料的生长和加工设备、向外延、LPCVD 等下游 CVD 设备延伸。（半导体行业观察）

**合肥欣奕华：完成 6 亿元股权融资。**近日，国内泛半导体智能装备供应商合肥欣奕华智能机器有限公司完成 6 亿元股权融资，本轮融资将用于高端装备的研发及扩产。对于本轮融资，合肥欣奕华 CEO 张海涛表示，将继续深耕泛半导体产业领域，打造以工业机器人+高端装备+智慧工厂解决方案为主的完整业务矩阵，为全球合作伙伴提供值得信赖的产品与技术服务。（半导体行业观察）

### 4.3. 代工/封测

**英特尔电解制氢及半导体产线电气系统制造项目开工。**8月28日，据中新网湖北报道，荆门市8月份重大项目集中开工在钟祥举行，此次集中开工包括英特尔电解制氢及半导体产线电气系统制造项目。报道称，英特尔电解制氢及半导体产线电气系统制造项目计划总投资额3.5亿元。项目计划分两期建设，其中一期新建车间10000平方米，办公用房3000平方米，新上两条电解制氢的核心设备生产线，配置功率测试平台、云数据平台、工艺示范平台等。项目建成达产后，可实现年销售收入1.5亿元，增加就业100人。（半导体行业观察）

**亚翔集成：中标台积电南京点3.25亿元机电统包安装工程项目。**9月1日，亚翔集成发布公告称，公司于近日收到台积电南京发来的采购订单，确认亚翔集成成为台积电南京F16P18 MEP package-Install（机电统包安装工程）的厂商，中标金额3.25亿元。公告显示，该项目为台积电南京12吋晶圆厂与设计服务中心的一期扩产及新建产线项目机电统包安装工程，计划扩充28nm芯片的产能，由每月4万片提升至10万片，工程预计完工日期为2022年6月1日。（半导体行业观察）

**台积电3nm将仍由苹果抢头香、拟推改款版。**台积电3nm制程即将于2022年下半年量产。业内传出，台积电3nm已进入风险性试产阶段，目标明年中旬月产能拉升至5~6万片规模，并由大客户苹果率先在iPhone导入；同时，公司也评估推出改款版3nm制程（即启动持续改善计划，Continuous Improvement Plan, CIP），提供客户兼具性价比的方案。（半导体行业观察）

**英特尔IDM2.0以扩大代工合作，连结台积电优势建构可扩展微架构。**外电报导，处理器龙头英特尔旗下企业规划事业部副总裁Stuart Pann日前发表文章，详细说明英特尔IDM2.0战略关键，就是“扩大代工合作”。英特尔新Intel ARC显卡品牌，以及全新独立游戏显卡SoC Ponte Vecchio就是在此策略下，采用合作伙伴晶圆代工龙头台积电制程代工，没有和处理器一样用英特尔自家晶圆厂生产。对英特尔来说，显卡并不是新领域，但英特尔重新努力构建可扩展的微架构，以支持图形处理应用，Xe-HPG架构下Xe-HPC架构显卡产品的重要零组件，将采用台积电N6和N5制程代工。（半导体行业观察）

**瑞萨：芯片供需料22年上半年趋缓，将积极投资扩增产能。**日经新闻2日报道，瑞萨社长柴田英利1日接受专访，关于芯片供需持续紧绷一事，柴田英利表示，“预估芯片供需有望在2022年上半年左右趋缓。只是，当前所有客户都处于库存枯竭状态，若不确保一定程度芯片数量的话，就无法回复至原先的营运。”柴田英利指出，为了稳定供应芯片、将进行积极投资，今后3年将进行大胆的投资来提升产能。目前，瑞萨将设备投资额占营收比重目标设定为5%左右，而预估今后投资水平将高于该目标值。上年度瑞萨投资额约220亿日元、投资比重仅约3%。（半导体行业观察）

**加快二期项目规划，坪山全力推动中芯国际12英寸生产线建设。**9月1日，深圳坪山区委书记杨军率队调研中芯国际等辖区重点企业。调研过程中，杨军表示，区委区政府将在人才、住房、交通、土地等方面为企业做好服务保障和配套支持，希望企业全力推动12吋生产线建设，加快二期项目规划建设，推动产业链上下游各类资源加速聚集，努力构建集成电路产业发展生态圈。（半导体行业观察）

**光库科技：铌酸锂高速调制器芯片项目封顶，将于明年投产。**9月1日，据光库科技官网

消息，8月31日上午，光库科技铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目封顶仪式在新园区内举行。新闻稿显示，铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目投资总额5.85亿元，总建筑面积约4万平方米，预计2022年封装测试中心投产。该项目主要包括芯片生产中心、封装测试中心和研发中心，其落成将填补国内高端光芯片空白并助力国家“新基建”，彻底解决光通讯产业“缺芯少核”和卡脖子难题，同时为大湾区光学芯片产业做好补链和积累。（半导体行业观察）

#### 4.4. EDA/IP/其他

**芯和半导体：联合新思科技业界首发“3DIC 先进封装设计分析全流程”EDA 平台。**8月30日，中国上海讯——国产 EDA 领军企业芯和半导体发布了前所未有的“3DIC 先进封装设计分析全流程”EDA 平台。该平台联合了全球 EDA 排名第一的新思科技，是业界首个用于 3DIC 多芯片系统设计分析的统一平台，为客户构建了一个完全集成、性能卓越且易于使用的环境，提供了从开发、设计、验证、信号完整性仿真、电源完整性仿真到最终签核的 3DIC 全流程解决方案。（集微网）

## 5. 周观点：

**看好市场上修全年预期。**高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，全年利润预期有望好于前期预测，景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期，进而带来相关股票的机会。

**IC 设计：关注新产品迭代与新应用需求。**21 年上半年淡季不淡，IC 设计板块收入同比增长快速，毛利率和净利率环比均有提高。关注新产品迭代与新应用需求，看好新产品新应用穿越周期。建议关注：**晶晨股份/中颖电子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易创新/富瀚微/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/芯朋微/澜起科技/紫光国微/上海复旦/斯达半导/新洁能**

**半导体制造：未来 5 年有望持续扩产，彰显成长性。**涨价+UTR 提升+产品结构优化。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来 5 年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大，战略性看多本土晶圆代工资产。建议关注：**中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技/中车时代电气/华润微/士兰微**

**半导体设备材料：成长趋势明确，受益制造产能扩张及国产替代加速。**芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料成长潜力较大。建议关注：**北方华创/雅克科技/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆科技**

## 6. 风险提示：

疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com